

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2002 年 10 月 17 日 (17.10.2002)

PCT

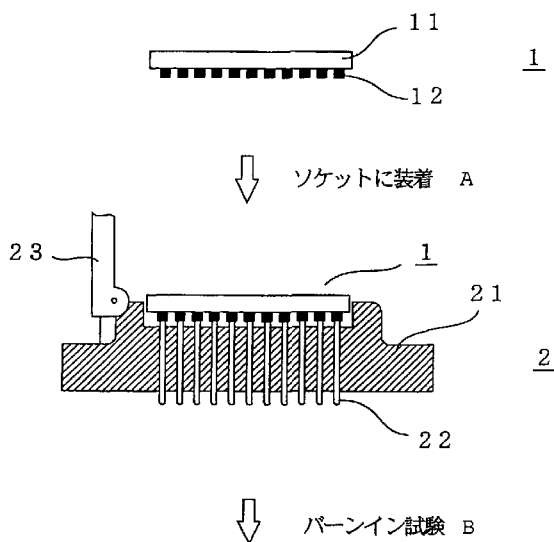
(10) 国際公開番号
WO 02/082592 A1

- (51) 国際特許分類: H01R 33/76, [JP/JP]; 〒103-8552 東京都 中央区 日本橋堀留町一丁目 9 番 1 1 号 Tokyo (JP).
C08K 3/04, 7/06, C08L 101/00
- (21) 国際出願番号: PCT/JP02/02945 (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 西畑 直光 (NISHI-HATA, Naomitsu) [JP/JP]; 〒974-8686 福島県 いわき市 錦町 落合 1 6 呉羽化学工業株式会社錦総合研究所内 Fukushima (JP). 多田 正人 (TADA, Masahito) [JP/JP]; 〒974-8686 福島県 いわき市 錦町 落合 1 6 呉羽化学工業株式会社錦総合研究所内 Fukushima (JP).
- (22) 国際出願日: 2002 年 3 月 27 日 (27.03.2002)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ: 特願2001-105212 2001 年 4 月 3 日 (03.04.2001) JP (74) 代理人: 西川 繁明 (NISHIKAWA, Shigeaki); 〒116-0014 東京都 荒川区 東日暮里三丁目 4 3 番 9 号 ビジュアル・シティー 4 0 1 号 Tokyo (JP).
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 呉羽化学工業株式会社 (KUREHA KAGAKU KOGYO K.K.) (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,

[続葉有]

(54) Title: IC SOCKET

(54) 発明の名称: ICソケット



(57) Abstract: An IC socket which is prepared by forming a thermoplastic resin composition comprising 40 to 94 mass % of a thermoplastic resin, 5 to 30 mass % of a carbon precursor having a volume resistivity of 10^2 to $10^{10} \Omega \text{ cm}$ and 1 to 30 mass % of an electroconductive filler having a volume resistivity of less than $10^2 \Omega \text{ cm}$. The IC socket is able to exhibit a surface resistivity which is strictly controlled to a desired level, and is excellent in electrically insulating property, mechanical properties, thermal resistance, chemical resistance, dimensional stability and the like.

A...ATTACHMENT TO SOCKET
B...BURN-IN TEST

[続葉有]



DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

表面抵抗率が所望の水準に厳密にコントロールされ、電気絶縁性、機械的特性、耐熱性、耐薬品性、寸法安定性等に優れる合成樹脂製のICソケット。熱可塑性樹脂40～94質量%、体積抵抗率 $10^2 \sim 10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$ の炭素前駆体5～30質量%、及び体積抵抗率 $10^2 \Omega \cdot \text{cm}$ 未満の導電性充填材1～30質量%を含有する熱可塑性樹脂組成物を成形して成るICソケット。